

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



G00002

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
30. Mai 2002 (30.05.2002)

PCT

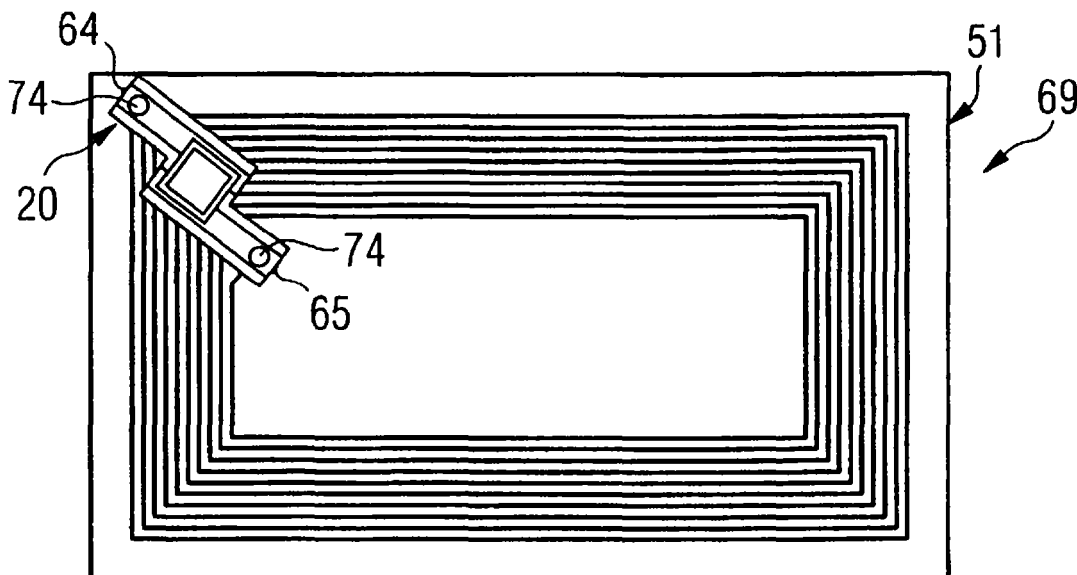
(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 02/42996 A1

- (51) Internationale Patentklassifikation⁷: **G06K 19/077** (72) Erfinder; und
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE01/04243 (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **AZDASHT, Ghassem**
[IR/DE], Reichsstrasse 70, 14052 Berlin (DE)
(22) Internationales Anmeldedatum: 14. November 2001 (14.11.2001) (74) Anwalt: **TAPPE, Hartmut**, Böck + Tappe Kollegen,
Kantstrasse 40, 97074 Würzburg (DE).
(25) Einreichungssprache: Deutsch (81) Bestimmungsstaaten (national): JP, KR, SG, US
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC,
NL, PT, SE, TR)
(30) Angaben zur Priorität: 100 58 804 2 27. November 2000 (27.11.2000) DE
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): **SMART PAC GMBH TECHNOLOGY SERVICES** [DE/DE], Am Schlangenhorst 17, 14641 Nauen (DE)
Veröffentlicht: — mit internationalem Recherchenbericht

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: CHIP MODULE AND CHIP CARD MODULE FOR PRODUCING A CHIP CARD

(54) Bezeichnung: CHIPMODUL SOWIE CHIPKARTENMODUL ZUR HERSTELLUNG EINER CHIPKARTE



(57) Abstract: The invention relates to a chip module (20) and to a method for producing a chip card. The invention involves a chip card module with a chip support (21) and a chip (22) that is contacted with conductor tracks (25, 26) of the chip support. The chip support has a flexible supporting substrate, and the conductor tracks extend over the length of the supporting substrate. In addition, the chip support (21) has two equally long longitudinal regions (35, 36), which are offset with regard to one another in the longitudinal direction of the chip support and which are respectively assigned to a conductor track (25, 26).

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 02/42996 A1



Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen

(57) Zusammenfassung: Chipmodul (20) und Verfahren zur Herstellung eines Chipkartenmoduls umfassend ein Chipmodul mit einem Chipträger (21) und einem mit Leiterbahnen (25, 26) des Chipträgers kontaktierten Chip (22), wobei der Chipträger ein flexibles Trägersubstrat aufweist und die Leiterbahnen sich jeweils über die Länge des Trägersubstrats erstrecken und der Chipträger (21) zwei gleichlange, in Längsrichtung des Chipträgers zueinander versetzte, jeweils einer Leiterbahn (25, 26) zugeordnete Längsbereiche (35, 36) aufweist.